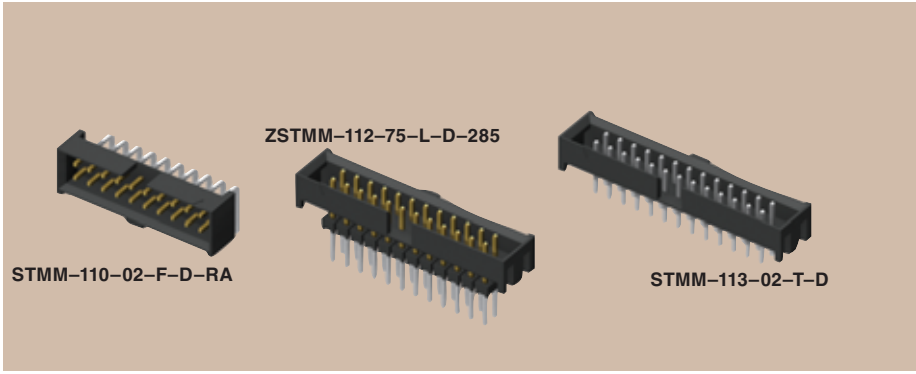


(2,00 mm) .0787"

STMM、ZSTMM 系列



遮蔽式 IDC 针座和堆叠器

配接：
TCSD

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?STMM 或 www.samtec.com?ZSTMM

绝缘体材料:
高温尼龙
端子材料:
磷青铜



电镀:
50μ" (1,27 μm) 镍镀层之上
镀金或镀锡
额定电流:
3A/触点 (80°C 环境温度时)
工作温度范围:
-55°C 至 +105°C 镀锡;
-55°C 至 +125°C 镀金
符合 RoHS 规范要求:
是

加工:
可无铅焊接:
是

SMT 引线共面度:
最大 (0,10 mm) .004"

还提供

遮蔽式板对板针座和堆叠器, 用于配接 SQT、SQW、ESQW 和 SMM 系列。请参阅 LTMM 和 ZLTMM 系列。

注: 为了增加机械稳定性, Samtec 推荐在板空间之内选用镀金或者选择性镀金的连接器。更多资讯, 请联系 ipg@samtec.com。

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。

注: 本系列为非标准型, 不可退换。

STMM	1	每排针数	02	电镀选项	D	焊尾选项	其他选项
05、08、10、12、13、15、17、20、22、25 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)			-F = 接线柱镀金, 焊尾镀雾锡 -L = 接线柱镀 10μ" (0,25 μm) 的金, 焊尾镀雾锡 -T = 雾锡		对于穿孔式, 保留空白 -RA = 直角 -SM = 表面贴装		-“XX” = 极化位置 -LC = 锁钩 (仅 -SM) (需要手动放置) -K = (7,50 mm) .295" 直径薄膜拾取贴装 (仅 -SM) -TR = 卷带封装 (仅 -SM)

ZSTMM	1	每排针数	引线式样	电镀选项	D	主体高度	其他选项
05、08、10、12、13、15、17、20、22、25 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)			指定引线式样 (参见图表)。	-F = 接线柱镀金, 焊尾镀雾锡 -L = 接线柱镀 10μ" (0,25 μm) 的金, 焊尾镀雾锡 -T = 雾锡		-“XXX” = 主体高度	-“XX” = 极化位置

引线式样	B (总长)	最大主体高度
-75	(9,58) 0.377	(7,42) 0.292
-62	(10,08) 0.397	(7,92) 0.312
-65	(10,49) 0.413	(8,33) 0.328
-73	(12,09) 0.476	(9,93) 0.391
-63	(14,10) 0.555	(11,94) 0.470
-66	(15,09) 0.594	(12,93) 0.509
-69	(15,60) 0.614	(13,44) 0.529
-74	(17,09) 0.673	(14,94) 0.588
-70	(17,60) 0.693	(15,44) 0.608
-71	(21,08) 0.830	(18,92) 0.745
-72	(21,62) 0.851	(19,46) 0.766

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM

SAMTEC 中国 • 上海市宜山路 889 号齐来大厦 601 座 • 邮编 200233

电话: 86-21-60833766 • 传真: 86-21-54234575 • 电子邮件: samtec.china@samtec.com